

枚葉式スパッタ装置 SP-12000M



枚葉式スパッタ装置SP-12000Mは基材(4インチまたは3インチウエハ)25枚用のカセットを1個収納できるロード室(アンロード室を兼ねる)を有する、枚葉式装置です。切り換えによりRFモードかDCモードを使用することが出来る生産用の装置です。

枚葉式スパッタ装置 SP-12000M 仕様

○到達圧力	×10 ⁻⁵ Pa台※常温・無負荷・脱ガス時
○排気速度	×10 ⁻⁴ Pa台迄15分以内※常温・無負荷・脱ガス時
○成膜室径	400mmW×400mmD×250mmH SUS304 電解研磨
○ロード室径	400mmW×400mmD×250mmH SUS304 電解研磨
○アンロード室径	400mmW×400mmD×250mmH SUS304 電解研磨
○スパッタ用電源	RF電源 13.56MHz 2kW 自動マッチング 1台 DC電源 700V 7kW 1台
○基板形状	3インチもしくは4インチ 1枚
○膜厚分布	3インチにおいて±10%以内
○ターゲット寸法	8インチ(金属・絶縁物)
○ターゲット個数	1
○基板回転	無し
○基板加熱	常温～250℃迄昇温可能
○真空排気系(成膜室)	油回転ポンプ:540L/min クライオポンプ:1500L/sec
○真空排気系(L,UL室)	油回転ポンプ:540L/min クライオポンプ:800L/sec
○操作方法	自動
○ガス系統	マスフローコントローラ 1系統
○ユーティリティ	電気:AC200V三相35kVA 冷却水:15L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環 計装エア:0.5MPa以上 設置寸法:3000mmW×2000mmD×1800mmH